



Welco LED101 免清洗型 SAC305 T6 号粉印刷锡膏

Welco LED101 SAC305 T6 是一款采用领先技术的免清洗型印刷锡膏，专门针对 mini-LED 和 micro-LED 芯片焊接以及系统级封装 (SiP) 应用而设计。这款锡膏设计的印刷场景为：每个钢网开孔覆盖 2 个或以上的基板焊盘，在回流过程中，锡膏自校准至焊盘，且不会出现桥连缺陷。LED101 印刷锡膏还具有高粘性，以确保 mini-LED 和 micro-LED 芯片高效转移。LED101 系列锡膏使用贺利氏电子专有的 Welco 锡粉制造技术，可实现低空洞率和高焊接良率，充分满足客户的超细间距应用要求。

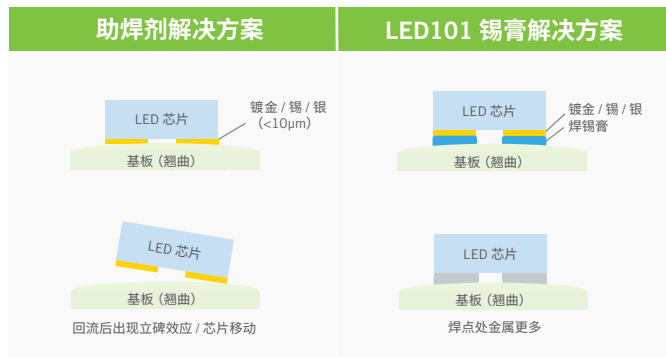
主要优势

- 使用高品质 Welco T6 号锡粉
- 免清洗，无卤素
- 回流过程中出色的自校准能力
- 超低空洞率
- 相比使用纯助焊剂，其焊接可靠性更高
- 钢网使用寿命长 (≥8 小时)，印刷后作业时间长 (≥8 小时)
- 高粘性 —— 确保 mini-LED 和 micro-LED 芯片高效转移

图 1：具有自校准能力的 Welco LED101 印刷锡膏

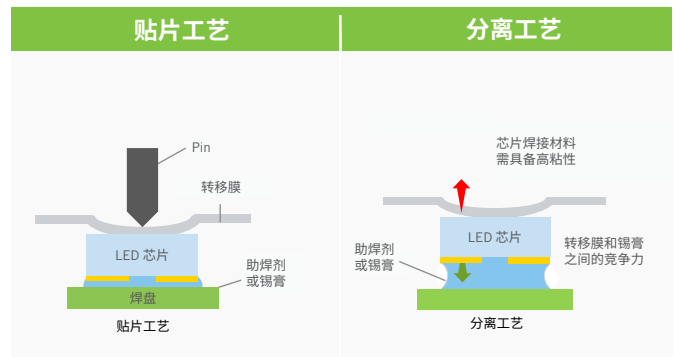


图 2：更高的焊接可靠性



- 随着 mini-LED 和 micro-LED 芯片越来越小，如果只使用助焊剂，就没有足够的锡膏来固定芯片
- 锡膏中的金属粉末有助于促进金属聚结，将芯片拉到基板上，并减少虚焊

图 3：高粘性 —— 确保芯片高效转移



- Welco LED101 的高粘性确保芯片高效转移

美洲
电话 +1 610 825 6050
electronics.americas@heraeus.com

亚太区
电话 +65 6571 7649
electronics.apac@heraeus.com

中国
电话 +86 53 5815 9601
electronics.china@heraeus.com

欧洲、中东和非洲
电话 +49 6181 35 4370
electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本（可索要最新版本文件）。尽管数据均准确无误，但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任（除非事先以协议的形式征得明确的书面同意）。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏和 Heraeus、Welco 和 Welco 图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。